汎用性を追究したソルダペースト

Solder Paste Pursuing Ultimate Versatility

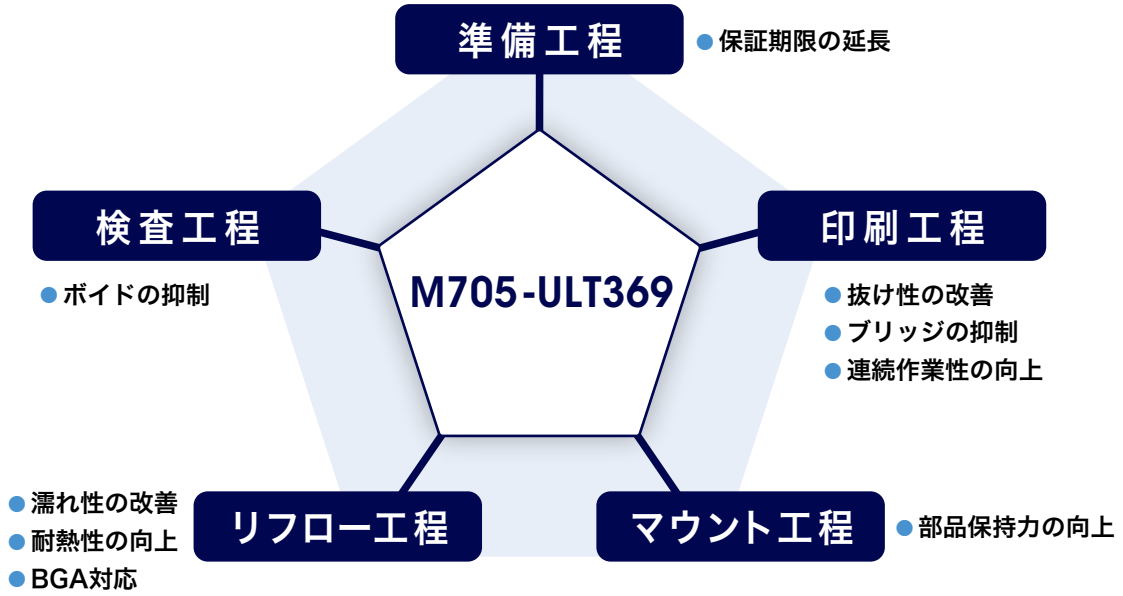
M705-ULT369は、表面実装工程での新たな使い易さを提供します

New M705-ULT369 for Better Printability, Wettability and Less BGA Solder Defects

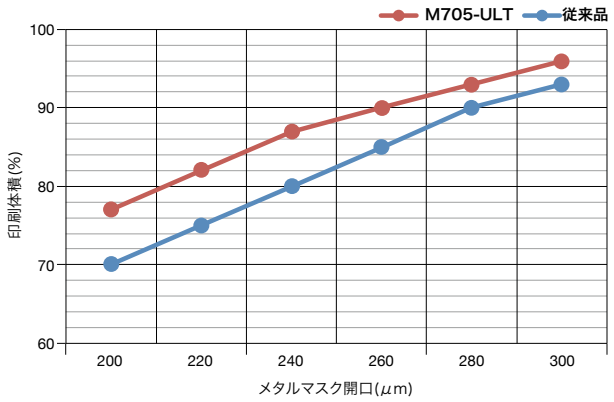
特　長

- 0402チップ部品に対して、安定したはんだ転写量
- QFPやQFNなどリード端面に対して、良好な濡れ上がり
- BGAの代表的な不良の未融合やNon-Wet Openに対応
- ソルダペーストの保証期限を延長

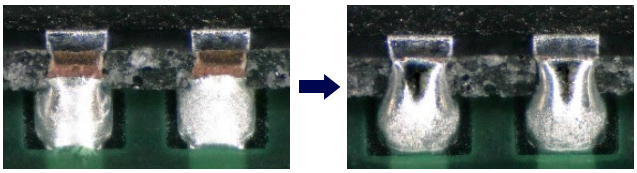
Revolutionary Products



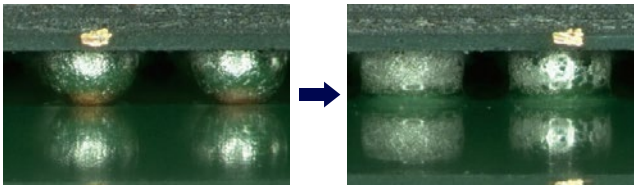
各マスク開口での転写量の比較



濡れ改善



BGA対策(Non-Wet Open)



NEP17-01

SMIC